

## 目录

特性参数.....	2
亮度分档.....	2
显指分档.....	2
电压分档.....	3
色区分档.....	3
光电性能特征曲线.....	4
出货编码规则.....	6
产品尺寸.....	6
包装规格.....	7
回流焊曲线.....	9
注意事项.....	10

## 产品特征

规格: 2.0 mm×1.6 mm  
倒装结构陶瓷封装  
典型光通量 (85℃)  
700mA: 230lm  
1000mA: 330lm

## 应用

汽车照明  
智能家居  
城市亮化

### 特性参数 (IF=700mA, T<sub>Solder pad</sub> =85℃)

项目	单位	最小值	典型值	最大值
发光角度	degrees (°)	--	115	--
正向电流	mA	--	700	1000
反向电压	V	--	5.0	--
正向电压(700mA,85℃)	V	--	3.2	--
正向电压(1000mA,85℃)	V	--	3.4	--
LED 结温	℃	--	--	150

### 亮度分档 (IF=700mA, T<sub>Solder pad</sub> =85℃)

级别	光通量范围(lm)
T3	220 ~ 240
T4	240 ~ 260
T5	260 ~ 280
T6	280 ~ 300

备注：亮度测试误差±7%

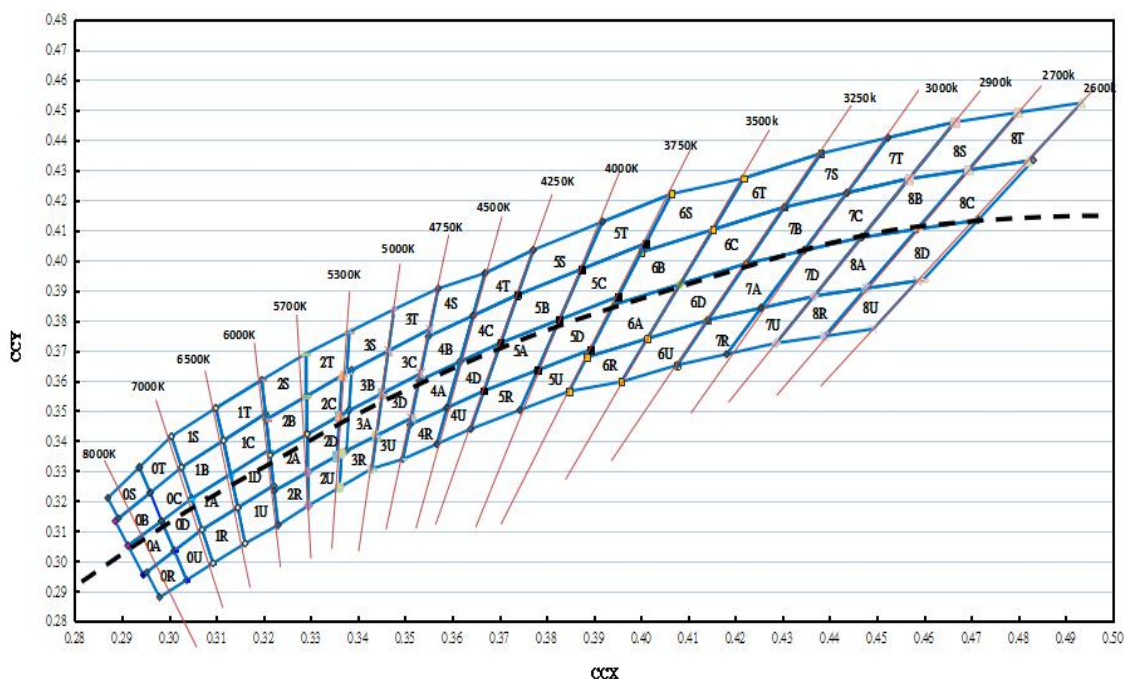
### 显指分档 (IF=700mA, T<sub>solder pad</sub> =85℃)

级别	范围
B0	70~100

## 电压分档 (IF=700mA, T<sub>solder pad</sub>=85℃)

级别	电压范围 (V)
V1	2.8~3.0
V2	3.0~3.2
V3	3.2~3.4
V4	3.4~3.6

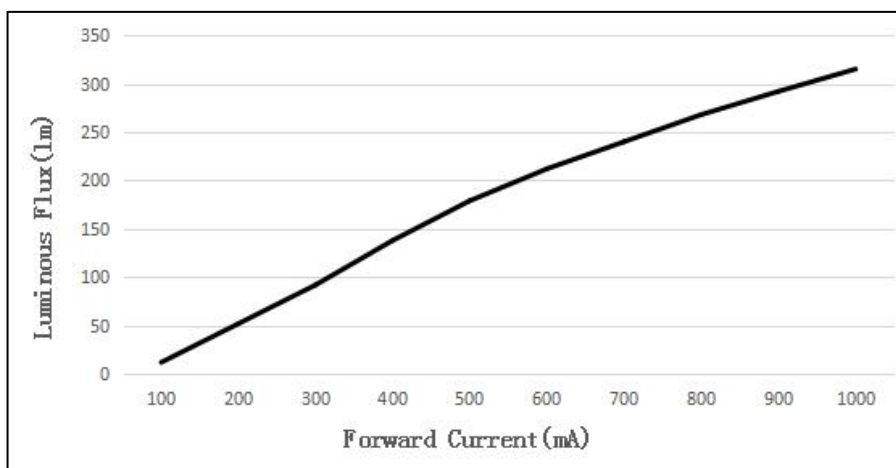
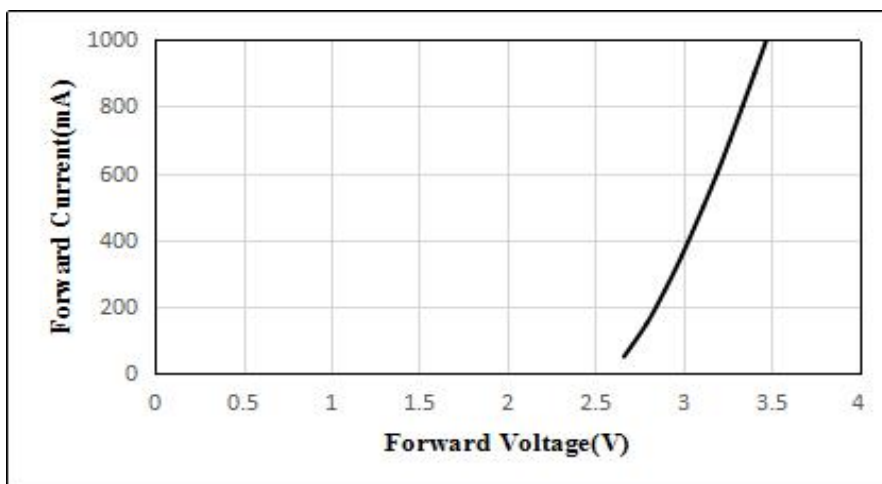
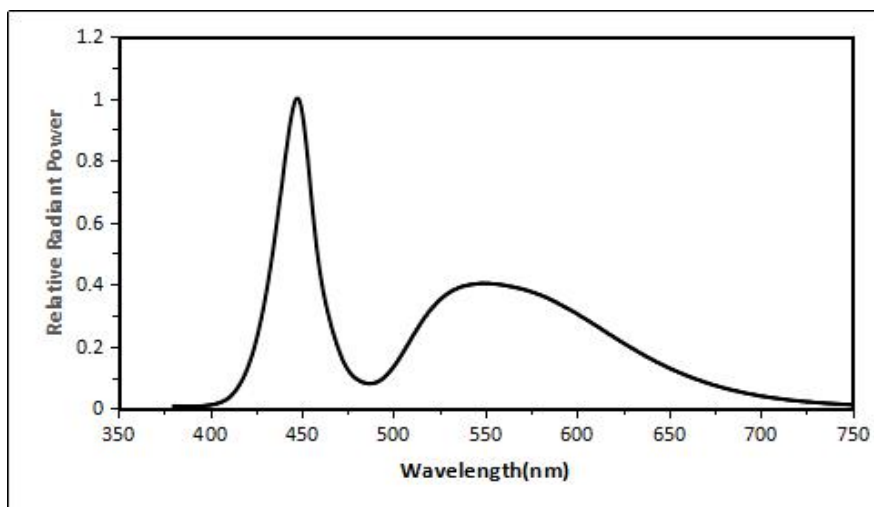
## 色区分档 (IF=700mA, T<sub>solder pad</sub>=85℃)

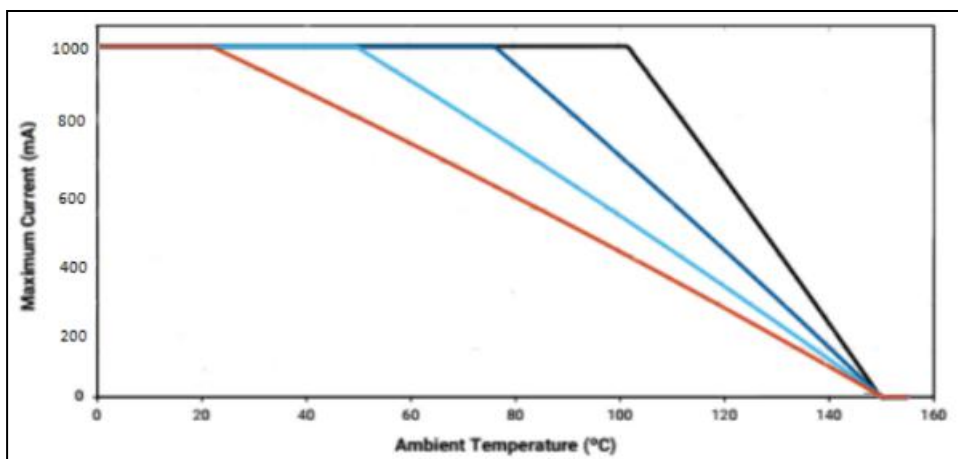
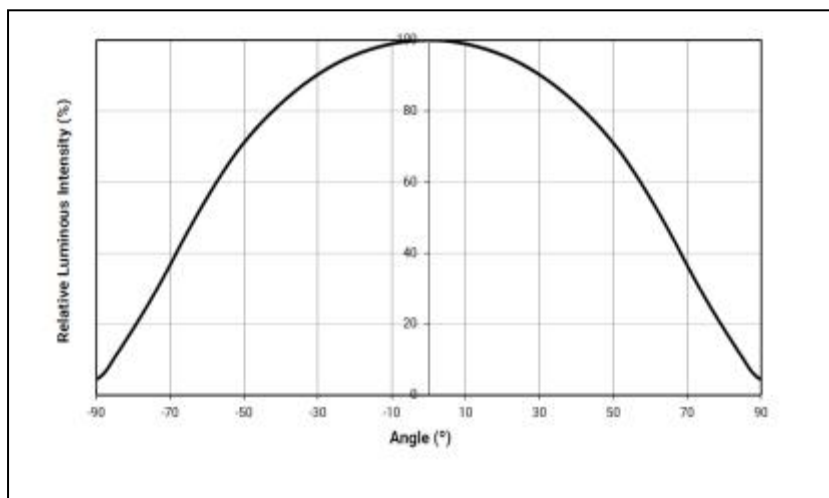


色度 & 色温对照表	
典型色温 (K)	色度区域
5000~5300	3S、3B、3A、3R
5300~5700	2T、2C、2D、2U
5700~6000	2S、2B、2A、2R
6000~6500	1T、1C、1D、1U
6500~7000	1S、1B、1A、1R

备注：色坐标 (CCx, CCy) 误差范围±0.005

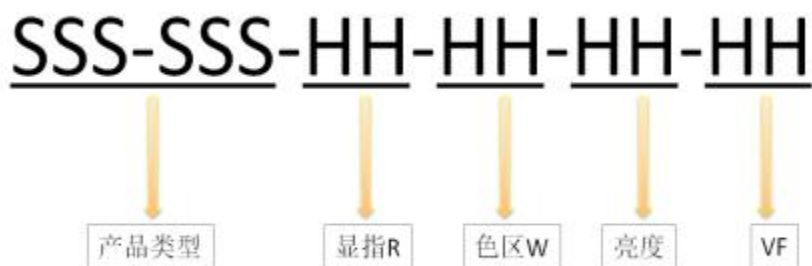
光电性能特征曲线 ( $I_F = 700 \text{ mA}$ ,  $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$ )





## 出货条码规则 ( $I_F = 700 \text{ mA}$ , $T_{\text{solder pad}} = 85^\circ\text{C}$ )

下图为产品编码规则

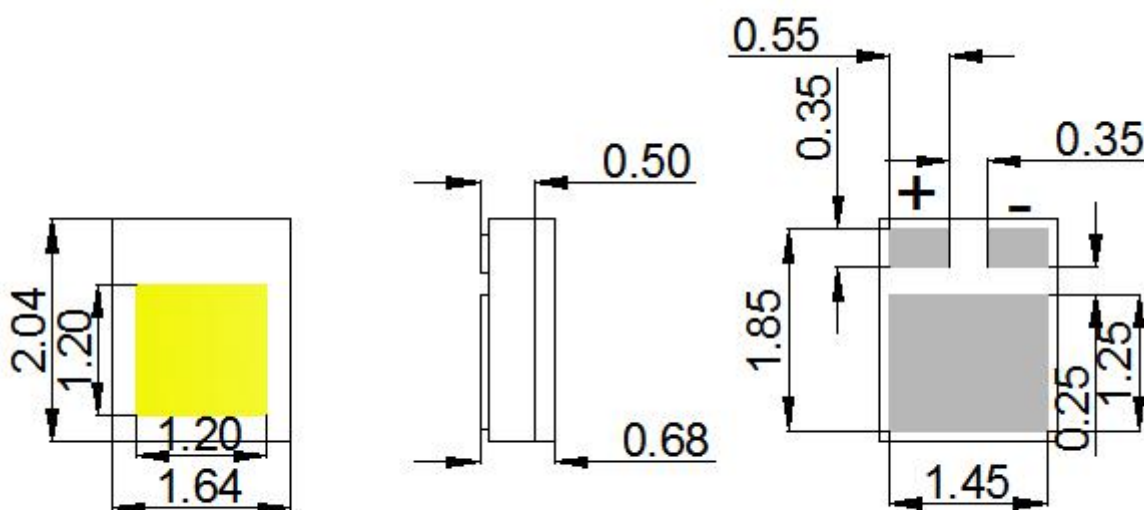


例如: LEFAWT-B0-1A-T4-V2, 其中 B0 表示显指; 1A 表示色温, 对应范围 6500K ~ 7000K; T4 表示亮度, 对应范围 240 ~ 260lm; V2 表示正向电压, 对应范围 3.0~3.2 V。

## 产品尺寸

单位: mm.

误差:  $\pm 0.05$

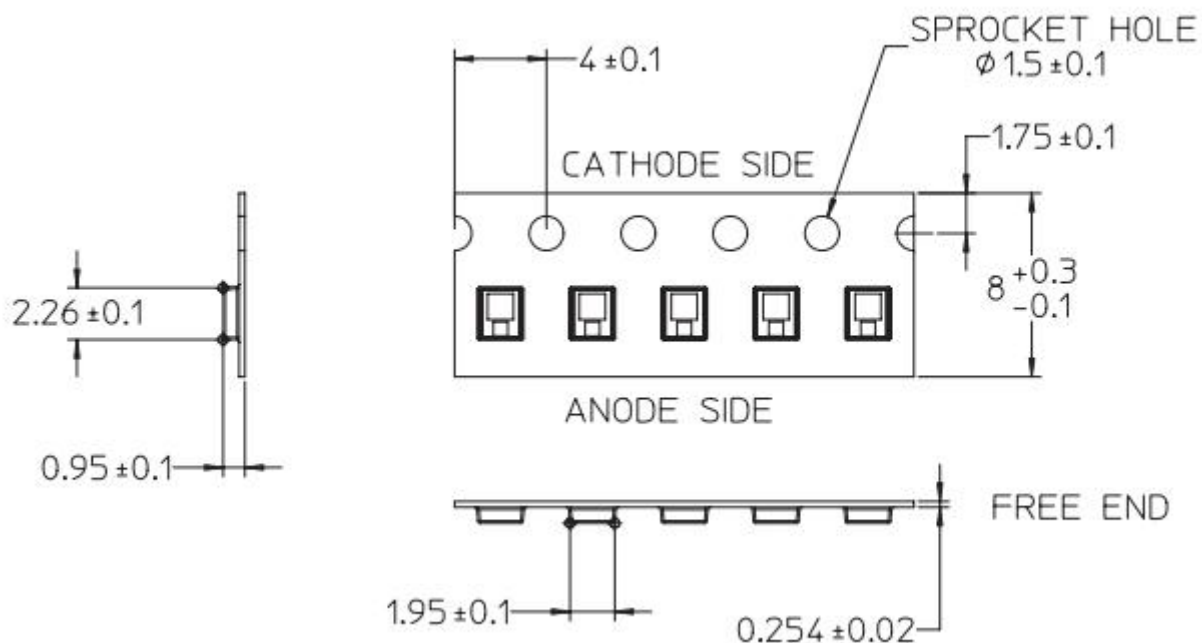


## 包装规格

包装方式：7 英寸卷盘包装 (包装数量：6000pcs)

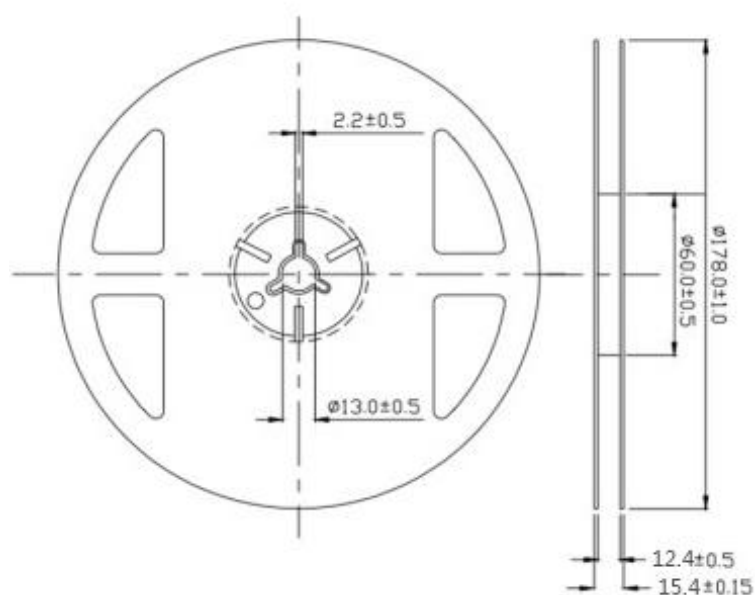
单位：mm

载带尺寸图

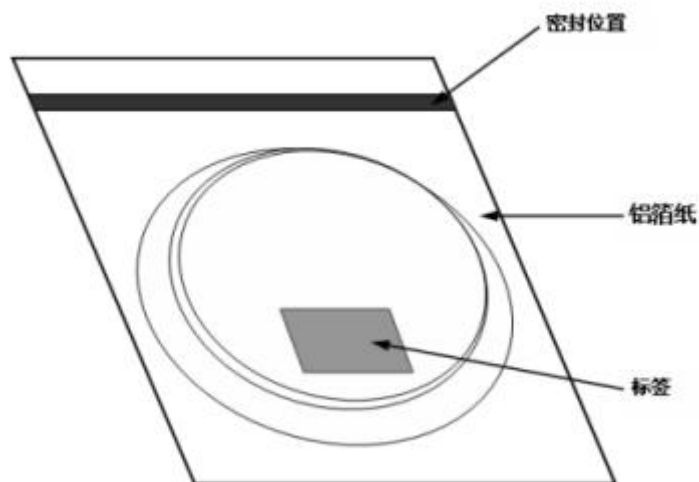


卷盘尺寸图

单位：mm



## 防潮包装



## 出货条码



Seal Date: 13-0cT-2016



Item: LEFAWT-B0-1A-T4-V2



BA



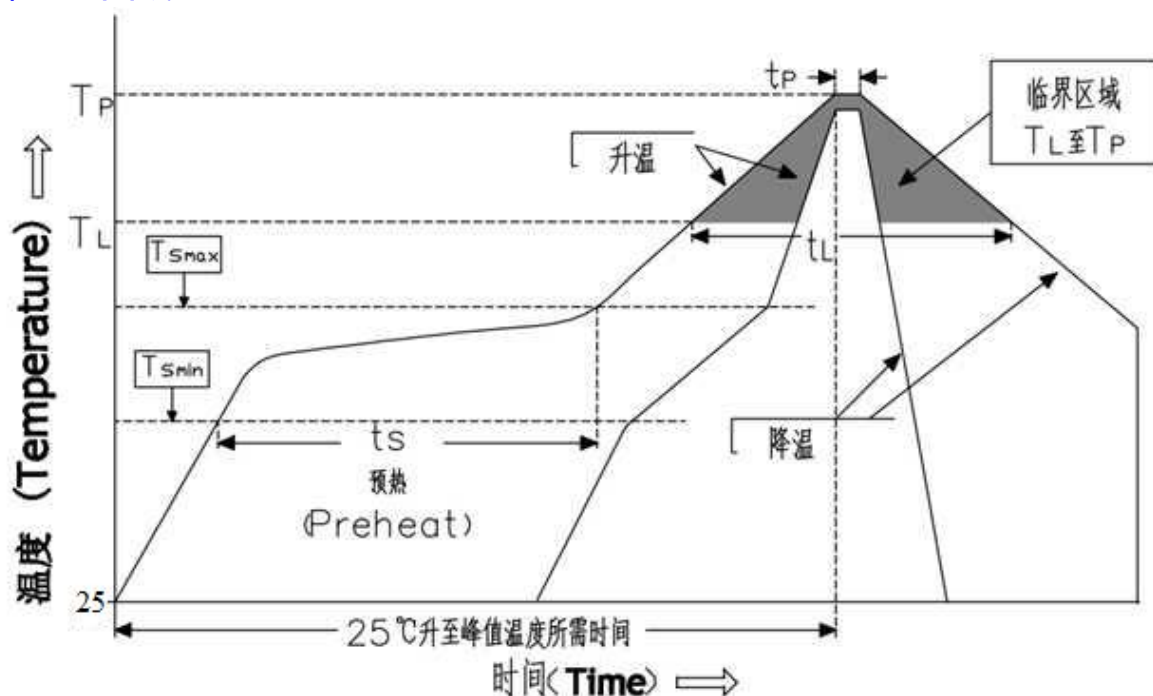
Qty: 6000

Reel IDALEFAWT0003211





## 回流焊升温曲线



分布特征	含铅回流焊	无铅回流焊
平均升温速度 ( $T_{Smax}-T_P$ )	3°C/second max.	3°C/second max.
最低预热温度 ( $T_{Smin}$ )	100°C	150°C
最高预热温度 ( $T_{Smax}$ )	150°C	200°C
预热时间 ( $t_{Smin}-t_{Smax}$ )	60~120 seconds	60~180 seconds
温度 ( $T_L$ )	183°C	217°C
维持在 $T_L$ 以上的时间 ( $t_L$ )	60~150 seconds	60~150 seconds
峰值温度 ( $T_P$ )	215°C	260°C
维持与实际峰值温度相差在 5°C 以内的时间 ( $t_P$ )	10~30 seconds	20~40 seconds
降温速度	6°C/second max.	6°C/second max.
从 25°C 升至峰值温度所需时间	6 minutes max.	8 minutes max.

备注：

1. 所有温度指封装表面温度，为封装体表面测定的数据；
2. 本回流焊曲线提供參考，并非适用于所有的 PCB 设计和回流焊设备；
3. 其他事项请参考《使用注意事项》。

## 使用注意事项

### 一、储存

1. 储存温度 5~30℃,相对湿度小于 28%。
2. 避免外力破坏真空包装袋,以防受潮。

### 二、使用

1. 正品锡膏,标准自动贴片机贴装。
2. 八温区以上回流焊,峰值温度小于 260℃,时间小于 10s。
3. 重复回流焊不超过 2 次。
4. 杜绝对灯珠施力受压,以免透镜刮伤、变形或脱落,造成死灯。
- 5 禁止使用有机溶剂或超声波。
- 6.焊接面空洞率小于 20%。
- 7.冷却后方能测试及使用。
- 8.做好静电防护。